



Not Rated

주가(7/25): 92,000원

시가총액: 11,662억 원



스몰캡 Analyst 오현진 ohj2956@kiwoom.com

RA 조재원 jwon2004@kiwoom.com

Stock Data

Table with 3 columns: Metric, Value, and Change. Rows include KOSDAQ (7/25), 52 주 주가동향, 최고/최저가 대비, etc.

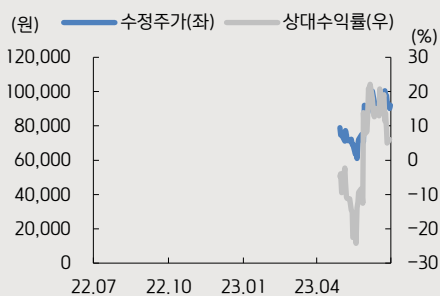
Company Data

Table with 2 columns: Metric and Value. Rows include 발행주식수, 일평균거래량(3M), 외국인 지분율, etc.

투자지표

Table with 5 columns: Metric, 2019, 2020, 2021, 2022. Rows include 매출액, 영업이익, EBITDA, etc.

Price Trend



기업 브리프

기가비스 (420770)

반도체 기판 고도화 수혜주



동사는 반도체 패키지 기판의 내부 회로 패턴을 검사하는 장비(AOI)와 레이저 기술을 활용하여 불량률 수리하는 장비(AOR)를 제조하는 업체이다. 동사 장비를 통해, 고객사는 수율 향상과 비용 절감이라는 효용을 얻을 수 있다. AI, 데이터센터 등 고성능 반도체 수요가 증가함에 따라 기판의 고도화도 가속화되고 있다. 글로벌 Top-tier 기술력을 보유한 동사에 시장 성장의 수혜가 집중될 것으로 판단한다.

>>> 고객사 수율 향상에 직접 기여하는 장비 라인업

동사의 장비 라인업(AOI, AOR)은 고객사의 패키지 기판 제조 수율 향상에 직접적으로 기여한다. 기판을 구성하는 하나의 레이어가 완성될 때마다 AOI(자동 광학 검사기)로 내부 회로 패턴 검사 및 불량률 선별하며, AOR(자동 광학 수리기)로 결함 수리를 진행해 양품화하게 된다. 주로, FC-BGA와 같은 고사양 기판 제조에 활용되고 있다. 최근 패키지 기판의 미세화, 다층화, 대형화 기조에 따라 제조 난이도가 상승하면서, 동사 장비에 대한 수요 역시 증가하고 있다. Ibiden, Shinko, Unimicron, 삼성전기 등 다수의 글로벌 Top-tier 기판 제조사를 고객사로 확보하고 있다.

>>> 성장하는 전방 시장과 제한적인 경쟁 강도

Prismark에 따르면, 패키지 기판 시장 규모는 2020년 102억 달러에서 연평균 10%씩 성장하여, 2025년에는 163억 달러까지 확대될 전망이다. 특히 AI, 자율주행 등 첨단 산업의 개화와 함께, 고성능 반도체와 고사양 기판 수요가 급증하고 있다. 이에 따라, 주요 기판 제조사 5곳의 합산 CAPEX 규모는 2020년 약 1조 9천억원, 2021년 약 2조 5천억원, 2022년 약 4조원으로 꾸준히 증가하고 있다.

경쟁 강도가 제한적이라는 점도 동사 장비의 가치를 배가시키는 요소이다. 미세 선폴 검사 기술 및 초정밀 레이저 가공 기술의 높은 난이도가 진입 장벽 역할을 하며, 동사는 선제적인 기술 개발을 통해 글로벌 선도 기술력을 보유한 것으로 파악된다.

>>> 반도체 기판 고도화 트렌드 속 높은 프리미엄 부여 가능

2023년 매출액 1,116억원(YoY +11.9%), 영업이익 432억원(YoY +27.8%, OPM 38.7%)을 전망한다. 반도체 업황 부진에 따른 기판 고객사들의 투자 축소 우려 있으나, 업황 반등 및 AI, 데이터센터 등 새로운 수요처 확대에 의한 수요가 실적 성장을 이끌 전망이다.

동사의 현재 주가(23년 기준 PER 30배)는 검사 장비 업체 평균 대비 높은 Valuation으로 인한 우려가 있을 수 있다. 다만 반도체 기판 고도화 트렌드에 부합하는 장비 라인업, 시장 내 높은 기술 경쟁력을 통해 높은 마진율 유지가 가능하다는 점을 반영할 시 보다 높은 Valuation 프리미엄 부여가 가능하다는 판단이다.

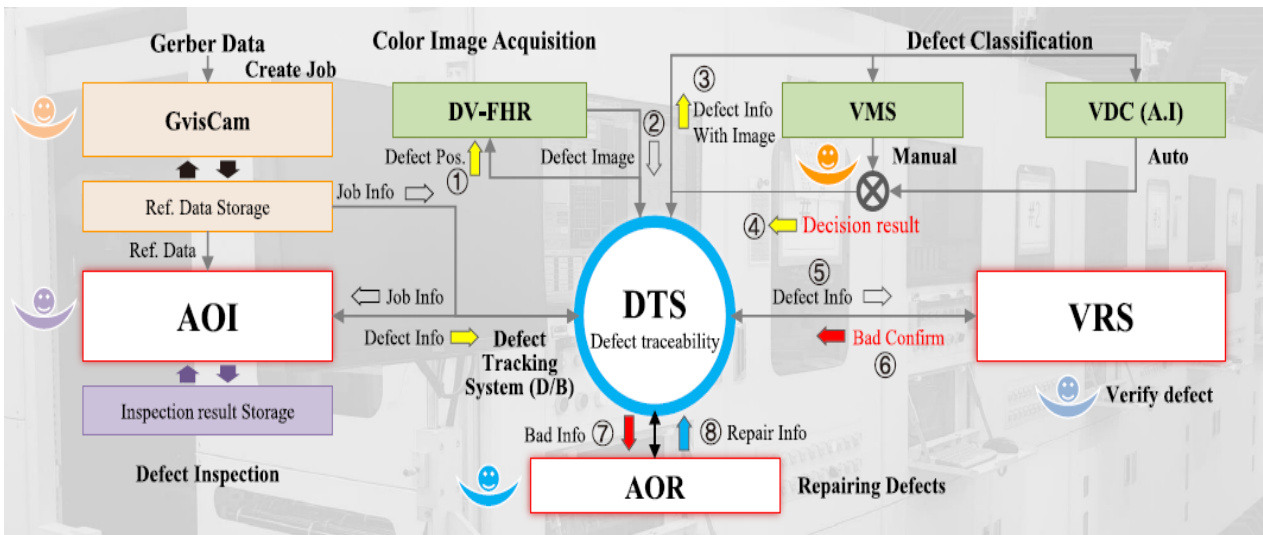
반도체 기판 검사 및 수리 장비 제조

동사는 반도체 패키지 기판의 내부 회로 패턴을 검사하는 장비(AOI)와 레이저 기술을 활용하여 불량을 수리하는 장비(AOR)를 제조하여 판매하는 업체이다. 현재 선평(L/S) 3/3 $\mu$ m 수준까지 검사 가능한 AOI 장비와, 5/5 $\mu$ m 수준의 불량을 양품화할 수 있는 AOR 장비 라인업을 보유 중이다. AOI, AOR과 같은 주요 장비들을 하나로 연결하여, 자동화된 In-Line 설비 형태로 납품하기도 한다.

FC-BGA는 절연층 역할을 하는 ABF 수지 위에 구리 금속 회로를 형성하여 하나의 레이어를 만들고, 이를 여러 층으로 적층하여 제작한다. 하나의 레이어가 완성될 때마다, AOI로 각 레이어 내부의 회로 패턴을 검사하고 불량을 선별하여, AOR을 통해 즉시 수리할 수 있다. 떨어져 있어야 할 구리 패턴이 붙어 있는 불량을 쇼트 불량이라고 칭하는데, AOR을 통해 붙어 있는 구리 부분을 제거하여 양품으로 전환시키는 원리이다. 특히, 동사는 열에 약한 ABF 수지의 손상(Resin Damage) 없이, 구리 회로만을 정확하게 수리할 수 있는 레이저 기술을 보유하고 있다. 이렇게 양품화 된 레이어들만을 활용하여 완제품을 제작할 수 있게 되기에, 고객사에서는 수율 향상과 비용 절감이라는 효용을 누릴 수 있다.

불량 기판을 수리해서 사용하기 위해서는, 반도체 기판 최종 고객사들의 승인 과정이 필요하며, 동사는 글로벌 반도체 완제품 업체의 승인을 받았다. 이를 통해 다양한 기판 제조사들에게 동사의 장비를 납품하고 있다. 현재 동사는 Ibiden, Shinko, Unimicron, 삼성전기 등 글로벌 Top-tier 반도체 기판 제조사 대부분을 고객사로 확보하고 있으며, 글로벌 반도체 완제품 업체와는 신제품을 개발 등 지속적인 협업을 진행 중인 것으로 파악된다.

기가비스 Total Solution 라인업 예시



자료: 기가비스, 키움증권 리서치센터

**투자포인트 ①**  
고객사 수율 향상에  
직접적으로 기여

동사 장비는 고객사의 반도체 패키지 기판 제조 수율 향상과 비용 절감에 직접적으로 기여한다는 점에서 경쟁력을 가지고 있다. 특히, 고성능 반도체 칩과 이를 뒷받침해줄 고사양 기판에 대한 수요가 확대되고 있는 시점에서 동사의 장비 경쟁력 더욱 중요해질 것이다.

고성능 반도체 칩의 원활한 구현을 위해서는, 더 많은 양의 전기적 신호를 빠르게 전달할 수 있는 주변 환경이 필요하다. 이를 위해, 패키지 기판의 내부 회로는 더욱 미세화되고, 회로 수는 더욱 많아져야 한다. 더욱 많은 회로를 배치하기 위해, 기판의 형태 역시 점점 다층 구조로 변화 중이다. 또한, Chiplet 기술 적용 등으로 인해 칩의 크기가 커짐에 따라, 기판의 크기 역시 대형화되고 있다. 이처럼, 패키지 기판의 미세화, 다층화, 대형화 기조에 따라, 생산 난이도가 높아지고 있다. 이에 수율 향상을 돕는 동사 장비에 대한 고객사들의 수요는 꾸준히 증가하고 있다.

구체적으로 살펴보면, 기판 업체들은 수율 향상을 위해 과거 10~20% 수준의 샘플링 검사 방식이 아닌 전수 조사 방식 채택을 확대하고 있다. 또한, 기판이 다층 구조로 제조됨에 따라 각 레이어별 검사 수요도 증가 추세이다. 더불어 고부가 장비에 대한 수요도 증가가 예상되는데, 회로 선폭 미세화 기조에 따라 고해상도 스펙을 갖춘 고가 장비에 대한 수요가 증가하기 때문이다. 동사의 장비는 선폭 3/3μm 수준까지 검사가 가능하다.

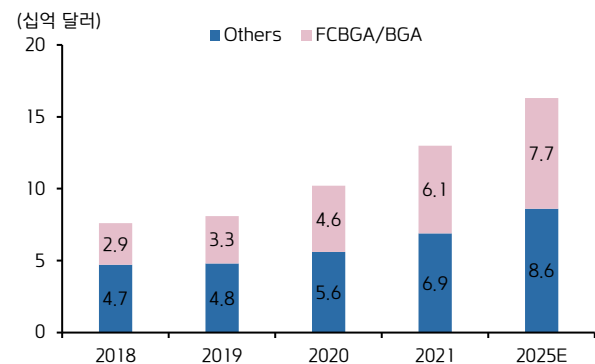
즉, 동사의 AOI, AOR 장비는 검사 대상(기판 내층 검사)과 검사 기술(수리 통한 양품화) 측면에서 기존의 외관 검사 장비 대비 고객사 수율 향상에 직접적 영향 행사가 가능할 것으로 판단한다.

**FC-BGA 반도체 기판 고도화**

특징	항목	PC용 기판	Server, AI, ADAS용 기판
미세화	Min L/S	9/12μm	5/5μm
다층화	Layer	8~10	20~26
대형화	Size	37.5mm*37.5mm	120mm*70mm

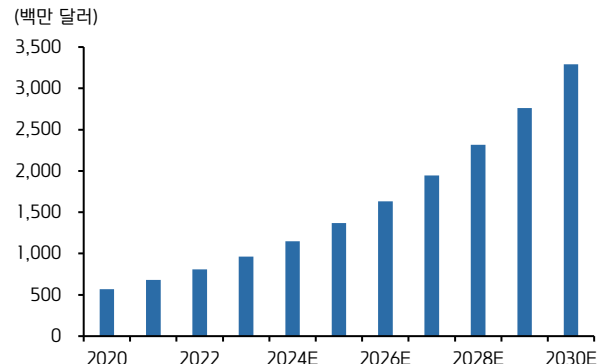
자료: 기가비스, 키움증권 리서치센터

**패키지 기판 시장규모 추이 및 전망**



자료: Prismark, 키움증권 리서치센터

**글로벌 AOI 시장 전망**



자료: allied market research, 키움증권 리서치센터

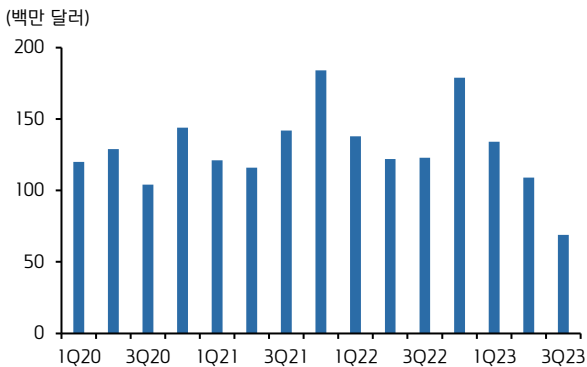
**투자포인트 ②**  
**성장하는 전방 시장과**  
**제한적인 경쟁 강도**

AI, 자율주행, 메타버스 등 첨단 산업의 개화와 함께 데이터 수요가 급증하였고, 이에 따라 고성능 반도체 수요 역시 급증하고 있다. 이와 더불어, FC-BGA와 같은 고사양 기판을 비롯한 반도체 패키지 기판에 대한 수요 또한 증가하고 있다. Prismark에 따르면, 2020년 102억 달러 수준이었던 패키지 기판 시장 규모는, 연평균 10%씩 성장하여 2025년에는 163억 달러까지 확대될 전망이다.

이에 발맞추어, 글로벌 기판 업체들도 CAPA 증설에 속도를 붙이고 있다. 일본의 Ibiden과 Shinko는 2023년부터 각각 2,500억엔 이상과 1,700억엔 가량을 패키지 기판 증설에 투입할 예정이다. 국내 기판 업체들의 투자도 활발하게 진행 중이다. 삼성전기는 2023년까지 1조 3천억원을 투입해 베트남 생산 기지를 증설하고, 6천억원 규모의 투자를 추가적으로 집행할 예정이다.

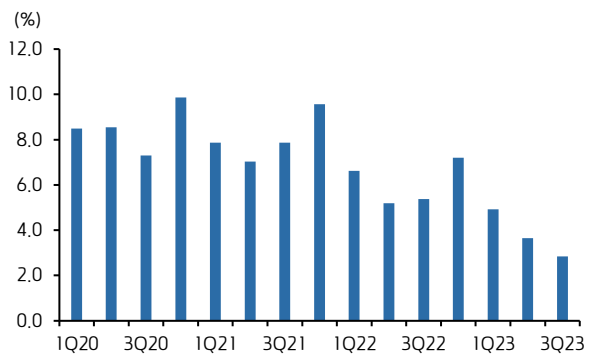
전방 시장의 성장에도 불구하고 경쟁 강도는 제한적이라는 점도 동사의 매력을 배가시키는 요소이다. 미세 선폭 검사 기술 및 초정밀 레이저 가공 기술의 높은 난이도가 진입 장벽 역할을 하고 있는 것으로 파악된다. 2019년 Orbotech을 인수한 글로벌 반도체 장비 회사 KLA 등이 동사의 주요 경쟁사이며, 동사는 선도적인 기술 개발과 우수한 장비 스펙(3μm 패턴 검사 능력 보유 등)을 앞세워 최근 시장 내 영향력이 높아지고 있는 것으로 파악된다. 한번 채택한 설비를 쉽게 변경하지 않는 고객사들의 보수적 성향을 감안하면, 동사의 시장 내 높은 점유율 유지가 가능할 전망이다.

KLA ‘PCB&디스플레이 검사 장비’ 매출액 추이



자료: KLA, 키움증권 리서치센터

KLA ‘PCB&디스플레이 검사 장비’ 매출비중 추이



자료: KLA, 키움증권 리서치센터

**주요 패키지기판 업체 투자 계획 및 규모**

기업	투자 시기	규모	내용
Ibiden	21~23년	1,800억 엔	IC PKG 기판 증설, Gama Plant
	23년~	2,500억 엔	Ono Plant 증설 계획
Shinko	22~25년	1,680억 엔	FC-BGA 증설, Arai, Chikuma Plant
Unimicron	~25년	미정	23년 CAPEX 규모 15% 하향 조정
삼성전기	22~24년	1조 9천억 원	FC-BGA 증설
LG이노텍	22~24년	4,130억 원	FC-BGA 증설
대덕전자	22~24년	2,700억 원	FC-BGA 증설

자료: 각 사, 언론종합, 키움증권 리서치센터

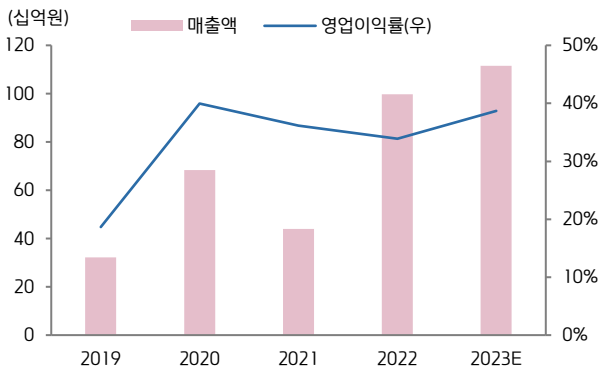
실적 전망 및 Valuation

2022년 매출액 997억원(YoY +126.6%), 영업이익 338억원(YoY +112.6%, OPM 33.9%)을 기록했다. 주식보상비용 약 100억원 등 일회성 비용이 발생했음에도 높은 영업이익률을 기록했음을 주목한다. 2022년말 기준 수주잔고는 1,228억원이며, 평균 lead time이 6~8개월임을 감안하면 높은 올해 실적 가시성을 보여준다.

이에 2023년 매출액 1,116억원(YoY +11.9%), 영업이익 432억원(YoY +27.8%, OPM 38.7%)을 전망한다. 반도체 업황 부진에 따른 기판 고객사들의 투자 축소 우려 있으나, 업황 반등 및 AI, 데이터센터 등 새로운 수요처 확대에 따른 수요가 실적 성장을 이끌 전망이다.

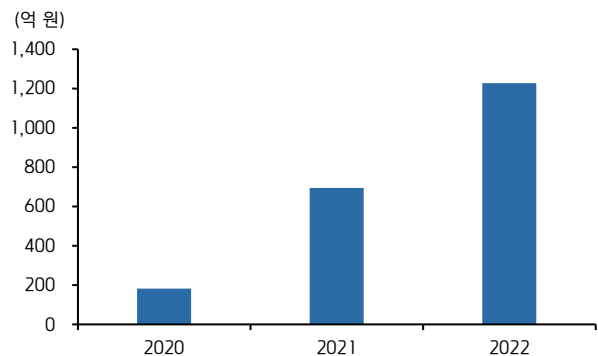
동사의 현재 주가(23년 기준 PER 30배)는 검사 장비 업체 평균 대비 높은 Valuation으로 인한 우려가 있을 수 있다. 다만 1) 장비 채택에 따른 고객사의 효용이 크다는 점(수율 향상 및 비용 절감), 2) 시장 내 높은 기술 경쟁력을 바탕으로 높은 마진을 유지가 가능하다는 점을 고려하여 보다 높은 Valuation 프리미엄 부여가 가능하다는 판단이다. 유사한 요건을 갖춘 장비 업체로는 대표적으로 HPSP와 파크시스템스 등이 있으며 이들의 현재 주가는 23년 PER 기준 35~40배 수준이다.

기가비스 실적 추이 및 전망



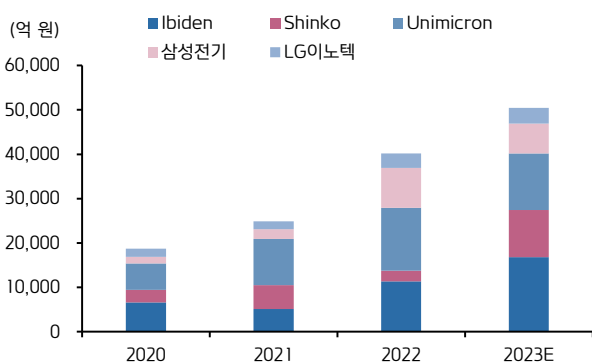
자료: 기가비스, 키움증권 리서치센터

연도별 수주잔고 추이



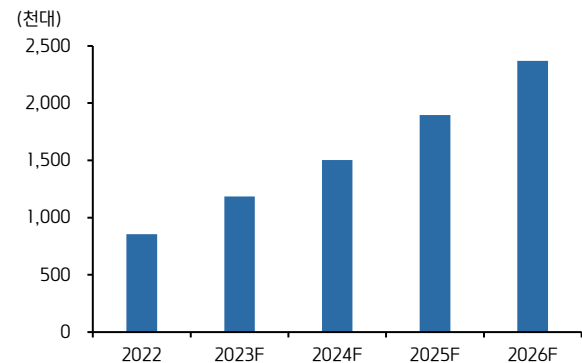
자료: 기가비스, 키움증권 리서치센터

주요 기판 제조사 CAPEX 추이 및 전망



자료: 각 사, 키움증권 리서치센터

글로벌 AI 서버 출하량 전망



자료: TrendForce, 키움증권 리서치센터

Peer 기업 Valuation Table

회사명	시가총액 (억 원)	PER		PBR		ROE		영업이익률	
		23E	24E	23E	24E	23E	24E	23E	24E
HPSP	29,339	41.9	28.1	12.9	8.9	33.2	38.0	27.3	18.2
파크시스템스	13,293	35.1	22.0	8.4	6.2	28.3	31.1	27.0	18.1
넥스틴	7,811	14.8	11.8	5.3	3.8	42.0	37.0	10.6	7.8
고영	10,442	26.3	21.6	3.1	2.8	12.5	13.9	17.7	12.5

자료: Bloomberg(23.7.20 기준), 키움증권 리서치센터

기가비스 주주구성

구분	공모 후 주식수	공모 후 지분율	매각 제한 기간	
유통제한물량	최대주주	2,226,742	17.6%	상장 후 2년 6개월
	최대주주 등	5,525,425	43.6%	상장 후 2년 6개월
	최대주주 등	450,500	3.6%	상장 후 6개월
	기존주주	1,084,629	8.6%	상장 후 6개월
	우리사주조합	132,169	1.0%	상장 후 1년
	우리사주-공모 이전 보유	315,000	2.5%	2027-09-29일까지
	<b>소계</b>	<b>9,734,465</b>	<b>76.8%</b>	
유통가능물량	기존 주주	855,204	6.8%	
	공모 주주	2,086,089	16.5%	
	<b>소계</b>	<b>2,941,293</b>	<b>23.2%</b>	
<b>합계</b>	<b>12,675,758</b>	<b>100.0%</b>		

자료: 기가비스, 키움증권 리서치센터

포괄손익계산서

(단위: 십억 원)

12월 결산, IFRS 연결	2018	2019	2020	2021	2022
<b>매출액</b>	9.5	32.2	68.3	44.0	99.7
매출원가	10.3	20.0	33.9	17.7	42.0
<b>매출총이익</b>	-0.8	12.3	34.4	26.2	57.8
판관비	3.5	6.3	7.1	10.3	23.9
<b>영업이익</b>	-4.3	6.0	27.3	15.9	33.8
<b>EBITDA</b>	-4.0	6.7	27.9	16.5	34.4
영업외손익	0.2	-0.7	-0.6	1.0	0.1
이자수익	0.3	0.2	0.4	0.4	0.9
이자비용	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
외환관련이익	0.1	0.5	0.6	0.6	2.9
외환관련손실	0.0	0.7	1.7	0.3	3.2
중속 및 관계기업손익	-0.7	-0.9	-0.1	0.3	-0.1
기타	0.5	0.2	0.2	0.0	-0.3
<b>법인세차감전이익</b>	-4.1	5.3	26.7	16.9	33.9
법인세비용	0.0	0.2	2.3	2.5	6.2
계속사업손익	-4.1	5.2	24.4	14.4	27.8
<b>당기순이익</b>	-4.1	5.2	24.4	14.4	27.8
<b>지배주주순이익</b>	-4.1	5.2	24.4	14.4	27.8
<b>증감율 및 수익성 (%)</b>					
매출액 증감율	-44.8	238.9	112.1	-35.6	126.6
영업이익 증감율	NA	흑전	355.0	-41.8	112.6
EBITDA 증감율	NA	흑전	316.4	-40.9	108.5
지배주주순이익 증감율	NA	흑전	369.2	-41.0	93.1
EPS 증감율	NA	흑전	371.0	-40.8	91.3
매출총이익율(%)	-8.4	38.2	50.4	59.5	58.0
영업이익률(%)	-45.3	18.6	40.0	36.1	33.9
EBITDA Margin(%)	-42.1	20.8	40.8	37.5	34.5
지배주주순이익률(%)	-43.2	16.1	35.7	32.7	27.9

현금흐름표

(단위: 십억 원)

12월 결산, IFRS 연결	2018	2019	2020	2021	2022
<b>영업활동 현금흐름</b>	-0.7	4.9	18.5	10.0	35.8
당기순이익	-4.1	5.2	24.4	14.4	27.8
비현금항목의 가감	1.5	3.7	2.0	3.3	21.9
유형자산감가상각비	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6
무형자산감가상각비	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
지분법평가손익	-0.7	-0.9	-0.4	-0.3	-0.1
기타	1.8	4.0	1.8	3.0	21.4
영업활동자산부채증감	1.9	-4.0	-7.8	-4.7	-11.7
매출채권및기타채권의감소	2.4	-3.5	-9.0	2.8	-15.8
재고자산의감소	-0.2	-2.6	1.9	-10.2	-7.5
매입채무및기타채무의증가	0.6	0.2	1.9	2.7	5.2
기타	-0.9	1.9	-2.6	0.0	6.4
기타현금흐름	0.0	0.0	-0.1	-3.0	-2.2
<b>투자활동 현금흐름</b>	-4.1	2.9	-12.9	-8.5	-27.0
유형자산의 취득	-3.1	-1.1	-1.2	-0.5	-1.2
유형자산의 처분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
무형자산의 순취득	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2
단기금융자산의감소(증가)	-1.0	4.0	-11.6	-7.9	-20.7
기타	-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-5.3
<b>재무활동 현금흐름</b>	0.0	-1.0	-5.0	-5.0	4.7
차입금의 증가(감소)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본금, 자본잉여금의 증가(감소)	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
자기주식처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2
배당금지급	0.0	-1.0	-5.0	-5.0	-5.0
기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8
<b>현금 및 현금성자산의 순증가</b>	-4.8	6.9	0.7	-3.5	12.8
기초현금 및 현금성자산	5.4	0.7	7.6	8.3	4.7
기말현금 및 현금성자산	0.7	7.6	8.3	4.7	17.5

자료: 키움증권

재무상태표

(단위: 십억 원)

12월 결산, IFRS 연결	2018	2019	2020	2021	2022
<b>유동자산</b>	19.1	27.9	47.5	59.2	122.9
현금 및 현금성자산	0.7	7.6	8.3	4.7	17.5
단기금융자산	12.5	8.5	20.1	27.9	48.7
매출채권 및 기타채권	2.7	6.0	15.0	12.2	26.9
재고자산	3.1	5.7	3.8	14.0	21.5
기타유동자산	0.1	0.1	0.3	0.4	8.3
<b>비유동자산</b>	12.3	11.8	12.7	13.6	18.5
투자자산	2.4	1.5	1.5	1.7	1.4
유형자산	9.8	10.2	10.9	6.0	6.7
무형자산	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
기타비유동자산	0.0	0.1	0.3	5.8	10.3
<b>자산총계</b>	31.4	39.7	60.2	72.8	141.5
<b>유동부채</b>	1.4	4.5	7.1	11.4	38.2
매입채무 및 기타채무	1.4	2.0	4.1	6.8	13.1
단기금융부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타유동부채	0.0	2.5	3.0	4.6	25.1
<b>비유동부채</b>	0.6	1.6	0.1	0.2	2.9
장기금융부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타비유동부채	0.6	1.6	0.1	0.2	2.9
<b>부채총계</b>	2.0	6.0	7.2	11.6	41.1
<b>지배지분</b>	29.4	33.6	53.0	61.2	100.4
자본금	0.1	0.1	0.1	0.1	2.1
자본잉여금	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8
기타자본	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타포괄손익누계액	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
이익잉여금	29.3	33.5	52.9	61.1	84.4
비지배지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>자본총계</b>	29.4	33.6	53.0	61.2	100.4

투자지표

(단위: 원, %, 배)

12월 결산, IFRS 연결	2018	2019	2020	2021	2022
<b>주당지표(원)</b>					
EPS	-393	493	2,323	1,376	2,633
BPS	2,804	3,202	5,048	5,826	9,464
CFPS	-247	848	2,511	1,691	4,711
DPS	0	100,000	450,000	250,000	750
<b>주가배수(배)</b>					
PER	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PER(최고)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PER(최저)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PBR(최고)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PBR(최저)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PSR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PCFR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EV/EBITDA					
<b>주요비율(%)</b>					
배당성향(% , 보통주, 현금)	0.0	38.6	36.9	34.6	28.7
배당수익률(% , 보통주, 현금)					
ROA	-12.4	14.6	48.8	21.7	25.9
ROE	-13.1	16.4	56.3	25.3	34.4
ROIC	-30.4	36.2	121.8	58.1	106.7
매출채권회전율	2.5	7.4	6.5	3.2	5.1
재고자산회전율	3.2	7.4	14.5	5.0	5.6
부채비율	6.7	18.0	13.6	18.9	40.9
순차입금비용	-44.6	-47.9	-53.6	-53.4	-65.9
이자보상배율					253.5
총차입금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
순차입금	-13.1	-16.1	-28.4	-32.7	-66.2
NOPLAT	-4.0	6.7	27.9	16.5	34.4
FCF	-5.1	1.4	16.4	8.3	14.8

Compliance Notice

- 당사는 7월 25일 현재 '기가비스(420770)' 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 금융투자분석사는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.

투자의견 및 적용기준

기업	적용기준(6개월)	업종	적용기준(6개월)
Buy(매수)	시장대비 +20% 이상 주가 상승 예상	Overweight (비중확대)	시장대비 +10% 이상 초과수익 예상
Outperform(시장수익률 상회)	시장대비 +10~+20% 주가 상승 예상	Neutral (중립)	시장대비 +10~10% 변동 예상
Marketperform(시장수익률)	시장대비 +10~-10% 주가 변동 예상	Underweight (비중축소)	시장대비 -10% 이상 초과하락 예상
Underperform(시장수익률 하회)	시장대비 -10~-20% 주가 하락 예상		
Sell(매도)	시장대비 -20% 이하 주가 하락 예상		

투자등급 비율 통계 (2022/07/01~2023/06/30)

매수	중립	매도
95.21%	4.79%	0.00%